



平成 29 年 5 月 31 日

各 位

会 社 名： 東京エレクトロン株式会社
 代表者名： 代表取締役社長 河合 利樹
 (コード番号： 8035 東証第 1 部)
 問合せ先： 総務部長 阿曾 達也
 (T E L 03-5561-7000)

新中期経営計画について

当社は、グローバル水準の収益性を追求し、持続的な企業価値の向上を目指しております。当社が 2015 年 7 月の中期経営計画の策定時に想定していた事業環境から、半導体製造装置の市場規模がさらに拡大するなど、当社を取り巻く事業環境は大きく変化しております。このような状況に鑑み、従前の中期経営計画を刷新し、2020 年 3 月期までの新たな中期経営計画を策定いたしました。

当社は、2020 年 3 月期の新たな財務モデル達成に向け、製品競争力のさらなる強化で、市場成長以上の売上高の伸長をめざすとともに、開発の効率性、業務の生産性を向上させ、収益力をさらに強化してまいります。

1. 財務モデルの半導体製造装置市場規模想定

- 2015 年 7 月公表の財務モデルは、経済状況に応じた市場環境の上限と下限にて提示
 (半導体前工程製造装置市場 300 億米ドル～370 億米ドル (ウェーハレベルパッケージング用の装置を含まない))
- 今回の財務モデルは、2020 年 3 月期の予測として、半導体前工程製造装置市場は 420 億米ドルから 450 億米ドル (ウェーハレベルパッケージング用の装置を含む) に到達するものと予測

2. 財務モデル (2020 年 3 月期までに達成)

(億円)

	2017 年 3 月期 (実績)	2018 年 3 月期 (予想)	2020 年 3 月期 (中期経営計画)	
半導体前工程製造装置* 市場規模	370 億 米ドル	400 億 米ドル	420 億 米ドル	450 億 米ドル
売上高	7,997	9,800	10,500	12,000
半導体製造装置	7,498	9,100	9,700	11,200
FPD 製造装置	493	700	800	800
売上総利益	3,222	4,120	4,520	5,220
下段：売上総利益率	40.3%	42.0%	43.0%	43.5%
販売管理費	1,665	1,960	2,000	2,100
下段：売上高販管費比率	20.8%	20.0%	19.0%	17.5%
営業利益	1,556	2,160	2,520	3,120
下段：営業利益率	19.5%	22.0%	24.0%	26.0%
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,152	1,630	1,800	2,200

* 半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、チップごとに切断・組立・検査をする後工程があります。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置であり、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含んでいます。

3. 財務モデル達成に向けて

- ・ 技術の差別化の追求
- ・ 開発部門統合によるコスト削減
 - － 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ(株)の設立
- ・ フィールドソリューション分野のさらなる需要拡大に対応
- ・ 業務の生産性を向上させ、固定費をコントロール
 - － サービス部門の業務効率を改善
 - － 現事業の利益率とのバランスの中で開発費の適正化を図る

4. 目標とする経営指標 (2020年3月期までに達成)

グローバル水準の利益率を保ちつつ、次世代製品開発を継続させ、持続的成長を目指します

半導体前工程製造装置*		
市場規模	420 億米ドル	450 億米ドル
売上高	10,500 億円	12,000 億円
営業利益率	24%	26%
ROE (自己資本利益率)	20%~25%	

5. 資本政策と株主還元策

資本効率についての考え方

成長投資に必要な資金を確保・創出しつつ、積極的な株主還元にも対処し、中長期的成長の視点をもって、適切なバランスシート・マネジメントに努めてまいります。具体的には、営業利益率、総資産回転率を向上させ、引き続きキャッシュフローの創出に努め、ROE (自己資本利益率) の向上を図ります。

株主還元についての考え方

当社の配当政策は業績連動型を基本とし、親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向50%を目処とします。ただし、1株当たりの年間配当金は150円を下回らないこととします。なお、2期連続で当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討します。

また、自己株式の取得については、機動的に実施を検討します。

以 上

* 半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、チップごとに切断・組立・検査をする後工程があります。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置です。また、半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含んでいます。